

課題番号 : F-18-UT-0135
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : トライボロジー計測のためのマイクロデバイス開発
Program Title (English) : Development of micro-devices for tribology measurements
利用者名(日本語) : 安藤泰久、大沢尚吾、木村柊
Username (English) : Y. Ando, S. Osawa, S. Kimura
所属名(日本語) : 東京農工大学大学院工学府 機械システム工学専攻
Affiliation (English) : Institute of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology
キーワード/Keyword : 膜加工・エッチング、DRIE、シリコン、静電アクチュエータ、トライボロジー計測

1. 概要(Summary)

DRIE 装置を利用し、マイクロデバイス開発を行った。用いた装置は、SPTS MUC-21 ASE-Pegasus である。作製したデバイスは、大別して 3 種類ある。何れも主にトライボロジー計測を目的としており、静電アクチュエータで駆動される。用いたウェハは、20 μ m のデバイス層を有する SOI ウェハである。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

高速シリコン深掘りエッチング装置 SPTS MUC-21 ASE-Pegasus

【実験方法】

加工に当たっては、VDEC を含めて 3 箇所にある設備を利用した。加工したデバイスは、3 種類である。

(1) レジスト成膜

スピコートにより、フォトリソを塗布し、オープンに入れてプリベークを行う。

(2) 露光・現像

マスクレス露光装置を用いてマスクパターンの転写を行い、現像を行う。

(3) DRIE 加工【VDEC】

VDEC の SPTS MUC-21 ASE-Pegasus を利用し DRIE 加工を行う。加工時間は、10 分以下である。

(4) ダイシング

デバイスを切り分け、BOX層のエッチングなどをおこなうことで、デバイスAは完成する。

(5) 酸化膜形成と FIB 加工

デバイスB、Cについては、ボックス層のエッチングは行わず、電気炉に入れて熱酸化膜を形成する。形成した熱酸化膜の一部を FIB 加工により除去する。

(6) DRIE 加工【VDEC】

酸化膜をマスクとして再び DRIE 加工を行う。このとき、ダイシングしたウェハをチャック状に傾けて設置することで、基板に対して傾いた構造が得られる。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

作製されたデバイスの一例を Fig.1 に示す。中央部に実験方法(6)の加工による傾斜構造が形成されている。

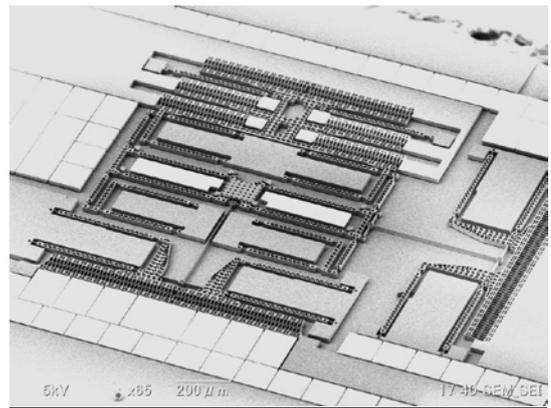


Fig.1 SEM image of 3D microstage

4. その他・特記事項(Others)

なし

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

- (1) 木村柊, 安藤泰久, 日本機械学会 第 9 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 平成 30 年 10 月 30 日.
- (2) 大沢尚吾, 安藤泰久, 日本機械学会 第 9 回マイクロ・ナノ工学シンポジウム, 平成 30 年 11 月 1 日.

6. 関連特許(Patent)

なし